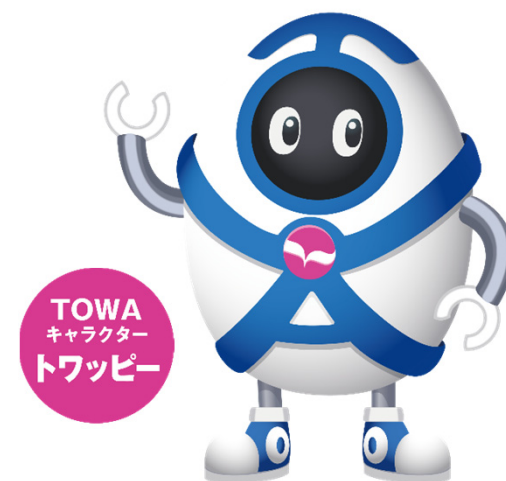




2025年3月期

第1四半期決算説明資料

2024年8月8日



[Click here for the English Ver](#)

TOWA株式会社

主な説明内容

1. 2025年3月期 第1四半期実績
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

主な説明内容

- 1. 2025年3月期 第1四半期実績**
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

2025年3月期第1四半期 サマリー

受注高
130.7 億円

売上高
132.5 億円

営業利益
22.1 億円

経常利益
24.2 億円

当期純利益
16.9 億円

▶ 当社独自のコンプレッション装置・金型の受注・売上ともに高水準を維持

生成AI関連向けや通信デバイス関連向けを中心に、当社独自のコンプレッション装置・金型の受注・売上が引き続き高い水準で推移。

▶ 売上高、各段階利益は前年同期比で増収増益

韓国や中国での設備投資は堅調に推移。台湾での投資も持ち直しつつあり、モールディング装置・金型の売上高が増加。また、顧客の稼働率改善に伴い、TSS（トータル・ソリューション・サービス）の売上高が増加したことから各段階利益ともに前年同期比で大幅に改善。

2025年3月期 第1四半期 連結業績結果

(単位：億円)

| | 24/3期 1Q実績 | 25/3期 1Q実績 | 増減額 | 前年比 |
|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 売上高 | 95.1 | 132.5 | + 37.4 | + 39.3% |
| 営業利益 | 9.2 | 22.1 | + 12.9 | + 140.3% |
| 経常利益 | 11.3 | 24.2 | + 12.8 | + 112.5% |
| 当期純利益 | 7.8 | 16.9 | + 9.0 | + 115.9% |

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2025年3月期 第1四半期セグメント別売上高

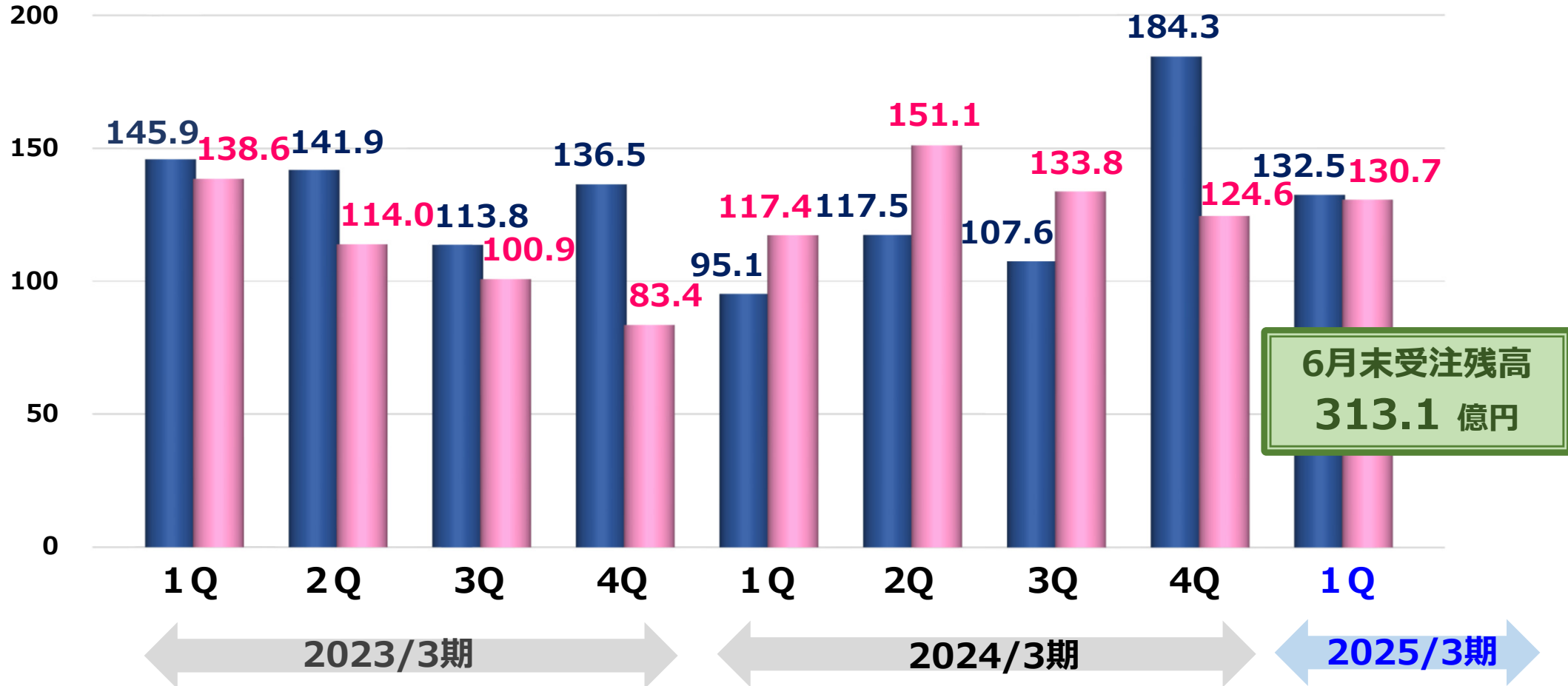
(単位：億円)

| | 24/3期 1Q実績 | 25/3期 1Q実績 | 増減額 | 前年比 |
|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| 売上高 | 95.1 | 132.5 | + 37.4 | + 39.3% |
| 半導体事業 | 71.0 | 100.6 | + 29.6 | + 41.7% |
| 化成品事業 | 5.5 | 5.7 | + 0.2 | + 3.8% |
| 新事業 | 14.4 | 22.0 | + 7.6 | + 52.8% |
| レーザ事業 | 4.2 | 4.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.2% |

受注・売上高の推移

(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高



地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

(単位：億円)

0 40 80 120 160

2024/3期
(1Q)



(2Q)



(3Q)



(4Q)



2025/3期
(1Q)



日本

台湾

韓国

中国

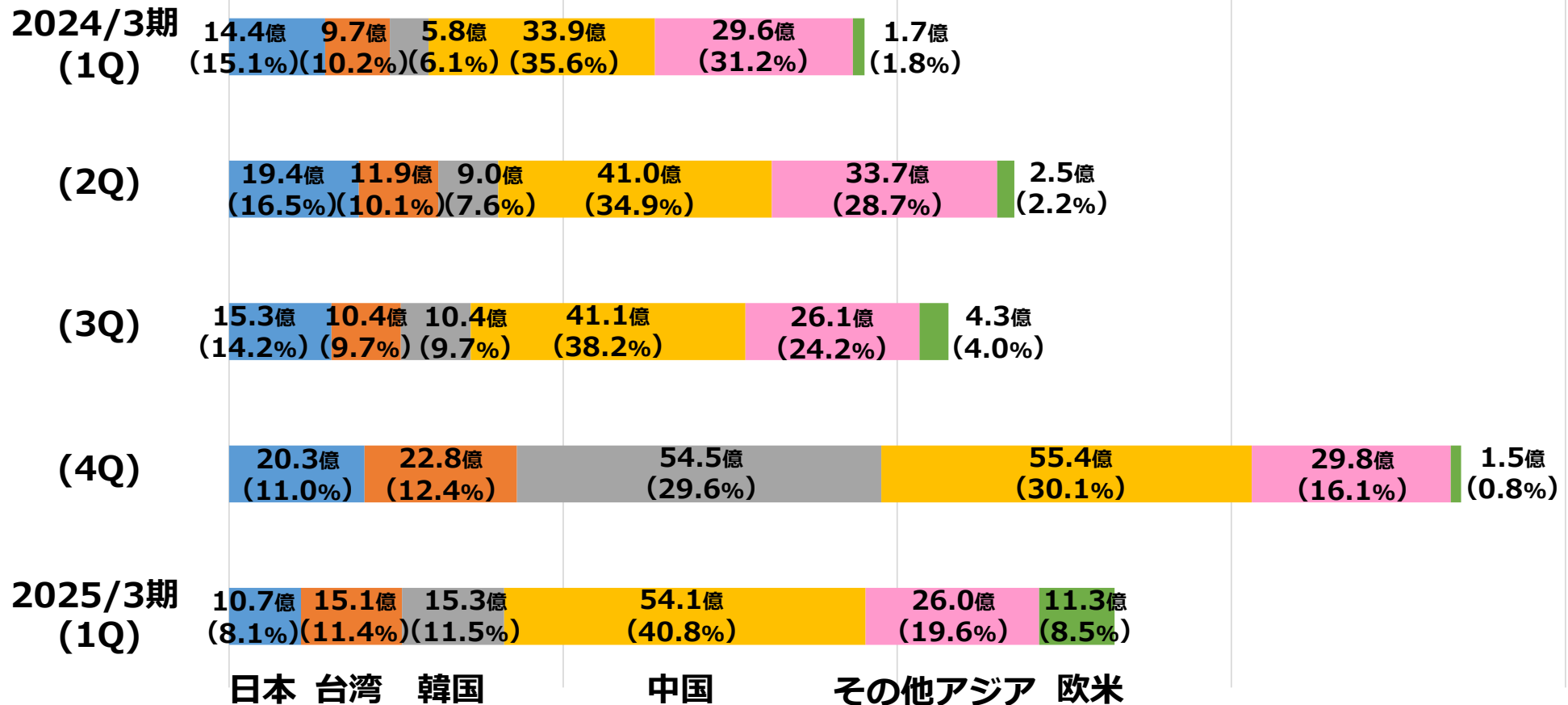
その他アジア

欧米

地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）

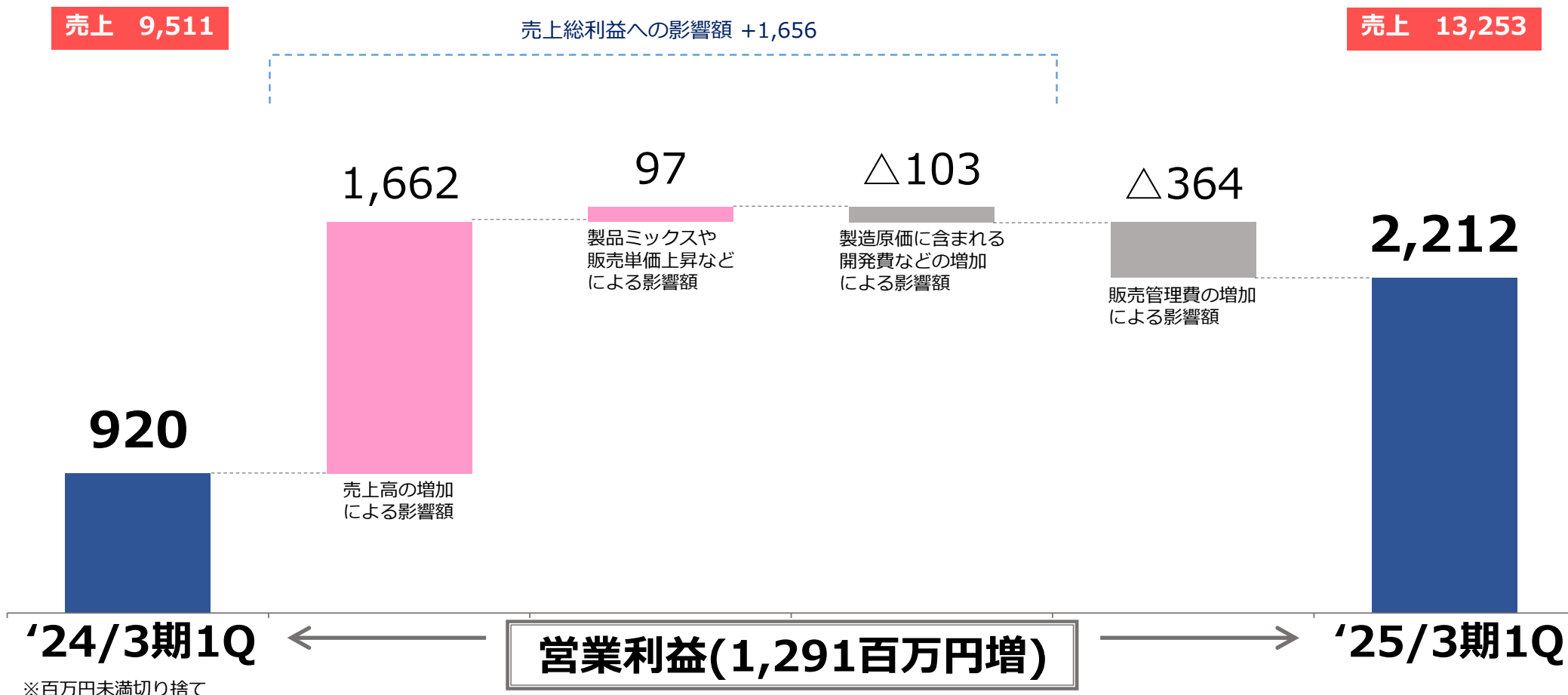
(単位：億円)

0 50 100 150 200



2025年3月期第1四半期 連結営業利益 増減要因分析 (対前年同期比)

(単位：百万円)



主な説明内容

1. 2025年3月期 第1四半期実績
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

2025年3月期 通期 連結業績予想

※期初予想から変更なし

(単位：億円)

| | 24/3期 通期実績 | 25/3期 予想 | | | 増減額 | 前期比 |
|-------|---------------|----------|-------|-------|--------|---------|
| | | 上期 | 下期 | 通期 | | |
| 売上高 | 504.7 | 287.0 | 313.0 | 600.0 | + 95.2 | + 18.9% |
| 営業利益 | 86.6 | 56.5 | 69.5 | 126.0 | + 39.3 | + 45.5% |
| 営業利益率 | 17.2% | 19.7% | 22.2% | 21.0% | — | + 3.8pt |
| 経常利益 | 90.7 | 56.5 | 69.5 | 126.0 | + 35.2 | + 38.8% |
| 当期純利益 | 64.4 | 39.6 | 48.7 | 88.3 | + 23.8 | + 37.0% |

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2025年3月期 セグメント別売上予想

※期初予想から変更なし

(単位：億円)

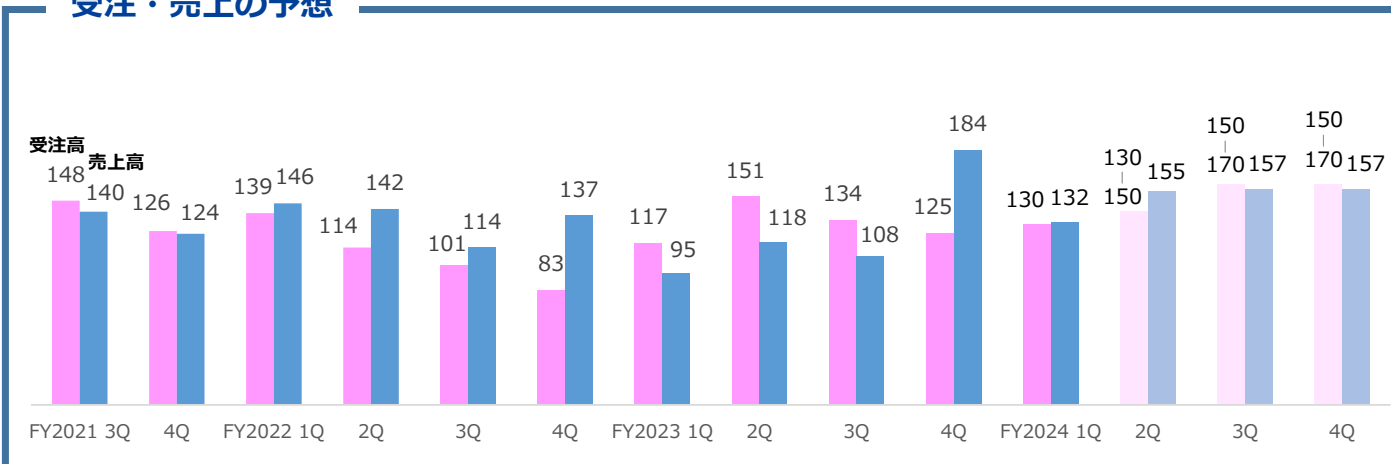
| | 24/3期 通期実績 | 25/3期 予想 | | | 増減額 | 前期比 |
|-------|---------------|----------|-------|-------|--------|---------|
| | | 上期 | 下期 | 通期 | | |
| 売上高 | 504.7 | 287.0 | 313.0 | 600.0 | + 95.2 | + 18.9% |
| 半導体事業 | 383.2 | 213.0 | 230.0 | 443.0 | + 59.8 | + 15.6% |
| 化成品事業 | 21.5 | 11.0 | 11.0 | 22.0 | + 0.5 | + 2.3% |
| 新事業 | 75.8 | 50.0 | 54.0 | 104.0 | + 28.2 | + 37.2% |
| レーザ事業 | 24.2 | 13.0 | 18.0 | 31.0 | + 6.8 | + 28.3% |

市場見通し

今後の市場見通し

- 2Q以降も生成AI関連の投資や中国での積極的な投資が市場を牽引する見通し
- 在庫調整が進み、OSATの稼働率は改善傾向にある。設備投資も2Qから下期にかけて徐々に回復すると予想し、当社売上についても2Qから上昇を見込む。

受注・売上の予想



受注高予想

2Q
130-150億円

3Q 4Q
150-170億円 150-170億円

損益予想

| | |
|------|---------|
| 売上高 | 600.0億円 |
| 営業利益 | 126.0億円 |
| 経常利益 | 126.0億円 |
| 当期利益 | 88.3億円 |

主な説明内容

1. 2025年3月期 第1四半期実績
2. 2025年3月期 通期予想
3. **TOPICS**

次世代半導体パッケージコンソーシアム参画

レゾナック社設立のUS-JOINT参画

北米の半導体メーカー、ファブレス、大手IT企業との生成AIや自動運転などの次世代半導体向けに当社コンプレッション装置を用いたパッケージ開発連携を強化



WLP向けコンプレッション装置
Model : CPM1080

| | |
|----|--|
| 名称 | US-JOINT (JOINT : Jisso Open Innovation Network of Tops) |
| 目的 | 米国における次世代半導体パッケージの評価プラットフォーム創成と実装技術の開発 |
| 拠点 | 米国カリフォルニア州 ユニオンシティ |

半導体・オブ・ザ・イヤーグランプリ受賞



第30回 半導体・オブ・ザ・イヤー2024
半導体製造装置部門 グランプリ 受賞

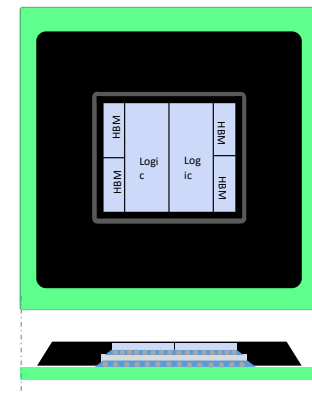
第30回

半導体・オブ・ザ・イヤー2024

生成AI向け半導体の
生産に最適な
モールディング装置



チップレット製品向けモールディング装置
Model : YPM1250-EPQ



チップレット製品
イメージ図

T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

参考資料



会社概要

| | |
|-------|---|
| 会社名 | TOWA株式会社 |
| 事業内容 | 半導体・LED製造装置、超精密金型、 ファインプラスチック成形品、レーザ加工装置 |
| 設立 | 1979年4月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岡田 博和 |
| 従業員数 | 2,047名(連結) [2024年6月末] |
| 資本金 | 89億円 |
| 証券コード | 6315 |
| 所在地 | 京都市南区上烏羽上調子町5番地 |

事業内容

新事業

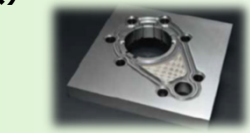
- ・ TSS (トータルソリューションサービス)
- ・ 精密加工用工具、受託加工
- ・ 微細加工
- ・ コーティング



改造・修理
予防保全



微細加工技術



受託加工



工具 (エンドミル)

レーザー加工装置事業

- ・ レーザトリマ
- ・ ウェハーマーカ
- ・ レーザ溶接機



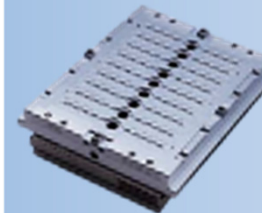
レーザートリミング装置
SL432R



ウェハーマーキング装置
SL473GS3

半導体事業

- ・ 半導体製造用精密金型
- ・ 半導体製造用モールド装置
- ・ 半導体製造用シンギュレーション装置



トランスファー金型



モールド装置
Model PMC2030-D



モールド装置
Model CPM1080

化成品事業

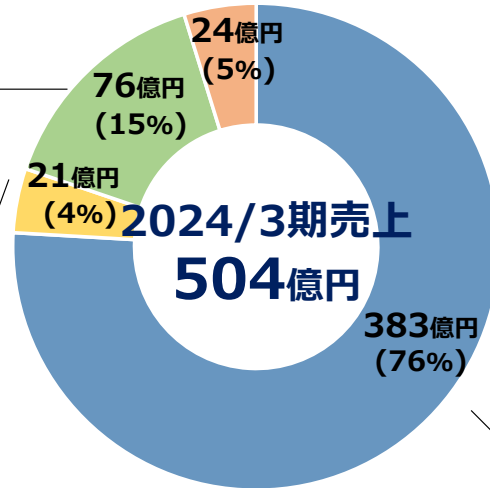
- ・ ファインプラスチック成形品
- ・ 医療機器



点滴用部品



注射器用部品



生産拠点

● TOWA ● グループ会社

 韓国

- TOWA韓国株式会社 半導体製造装置、精密金型、部品の製造
- TOWAファイン株式会社 ブレードの製造



 中国

- TOWA半導体設備（蘇州）有限公司 半導体製造装置、精密金型の製造



- 東和半導体設備（南通）有限公司 半導体製造装置、精密金型の製造



 マレーシア

- TOWAM Sdn. Bhd. 半導体製造装置の製造
- TOWA TOOL Sdn. Bhd. 半導体製造用金型の製造



京都

- 本社・工場（京都市）

半導体製造装置、精密金型の開発・製造



京都

- 京都東事業所（宇治田原町）

半導体製造用金型の製造



佐賀県（鳥栖市）

- 九州事業所

半導体製造用金型の製造



 日本

山梨県（韮崎市）

- 株式会社バンディック

ファインプラスチック成形品の製造



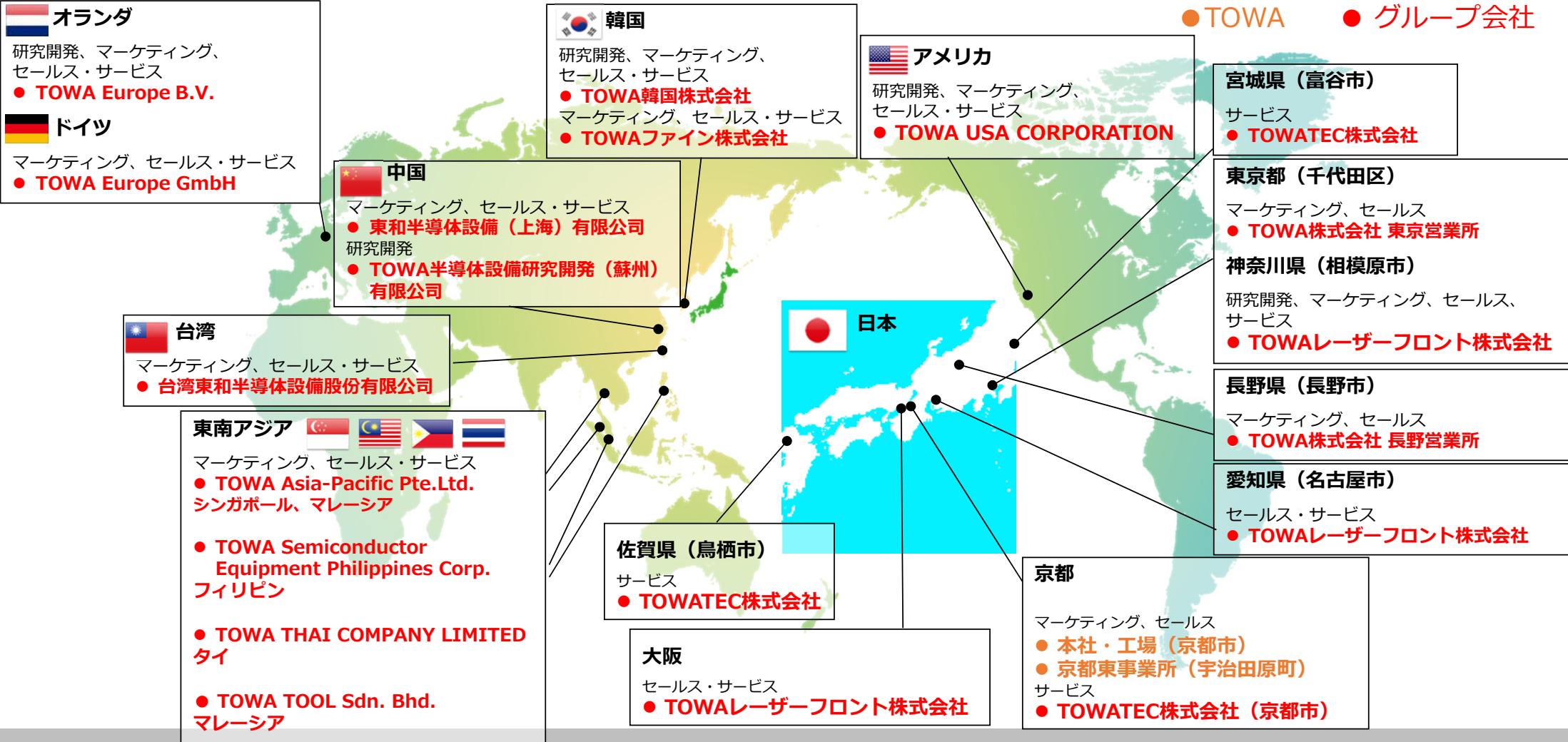
神奈川県（相模原市）

- TOWAレーザーフロント株式会社

レーザ及びびレーザ加工装置の開発、製造

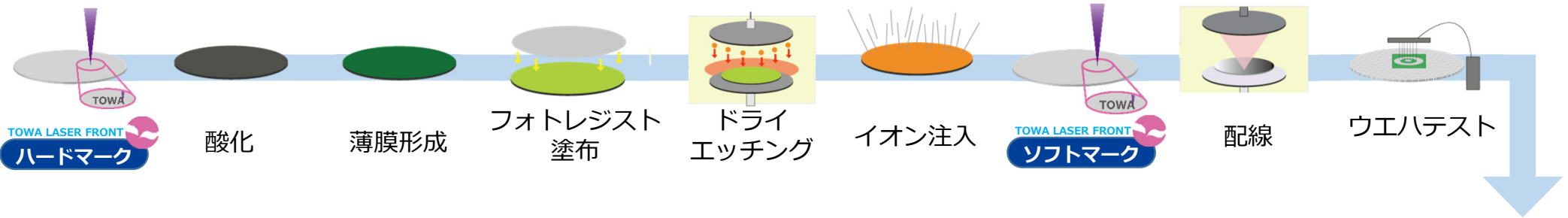
販売・サービス拠点

● TOWA ● グループ会社



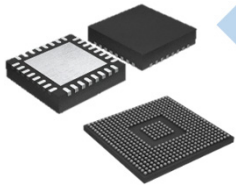
半導体が出来るまで

前工程

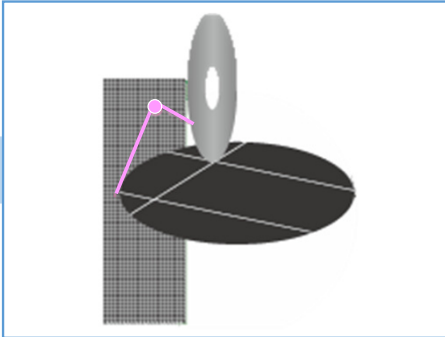


製品検査や
信頼性試験を
経て・・・

**半導体
完成！**

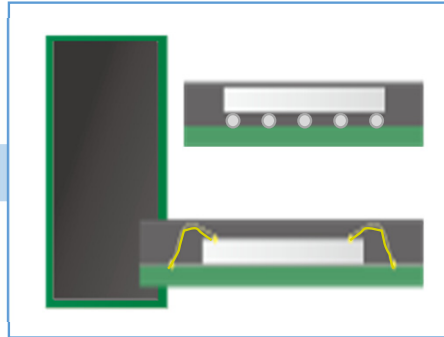


シンギュレーション



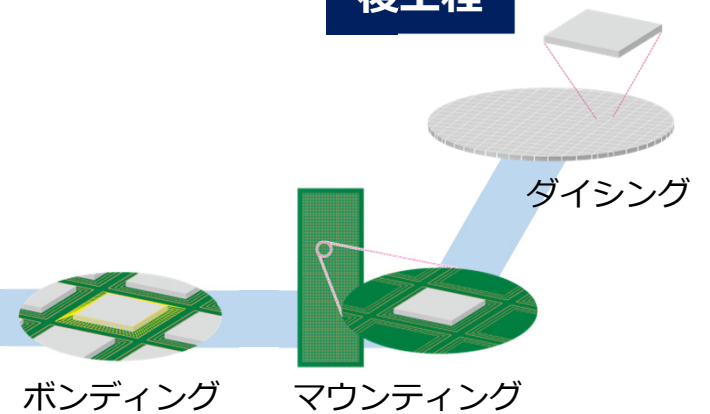
フレームから個々の製品を
切り離します。

モールドイング



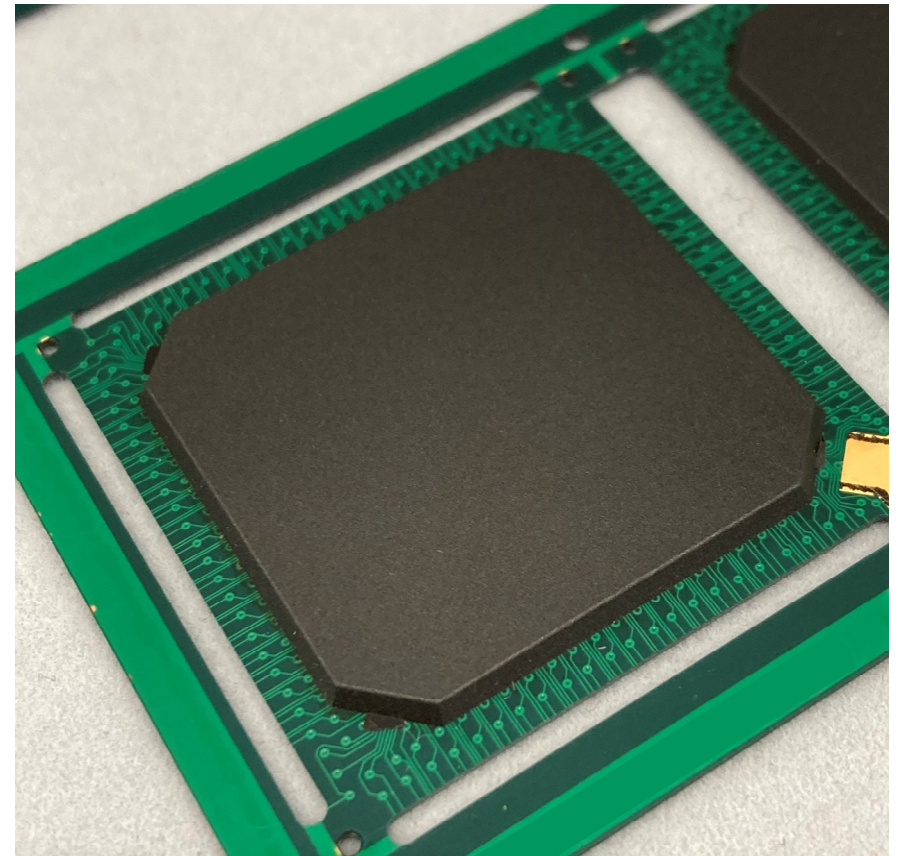
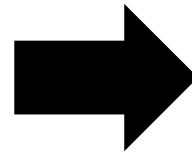
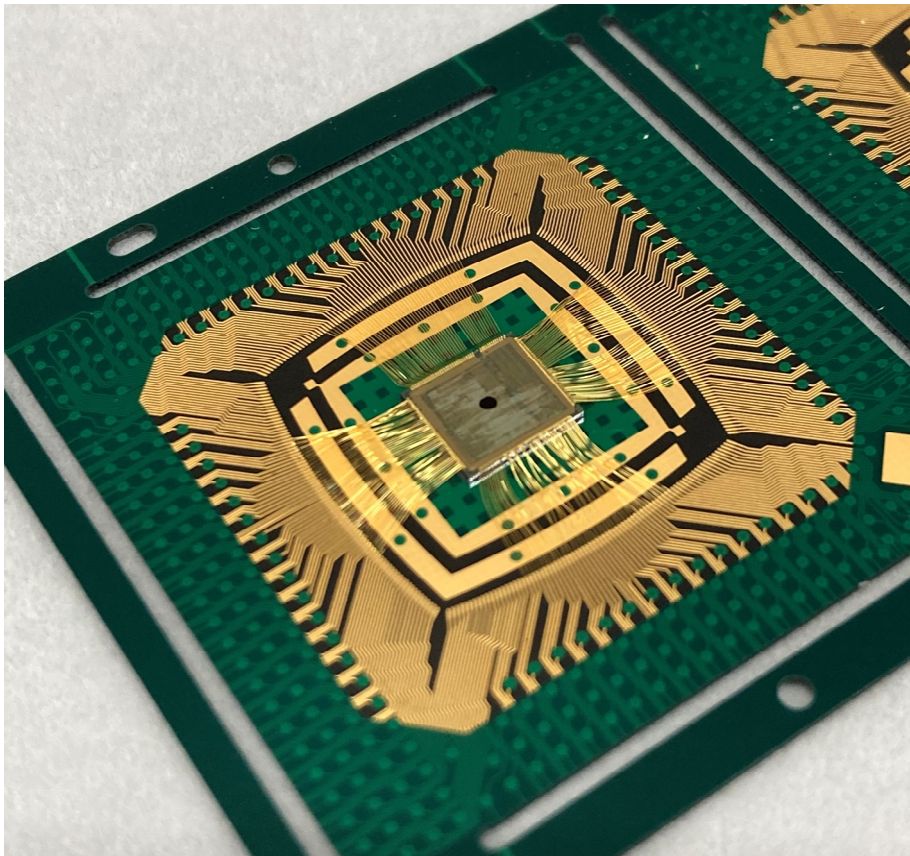
チップを樹脂で封止します。

後工程



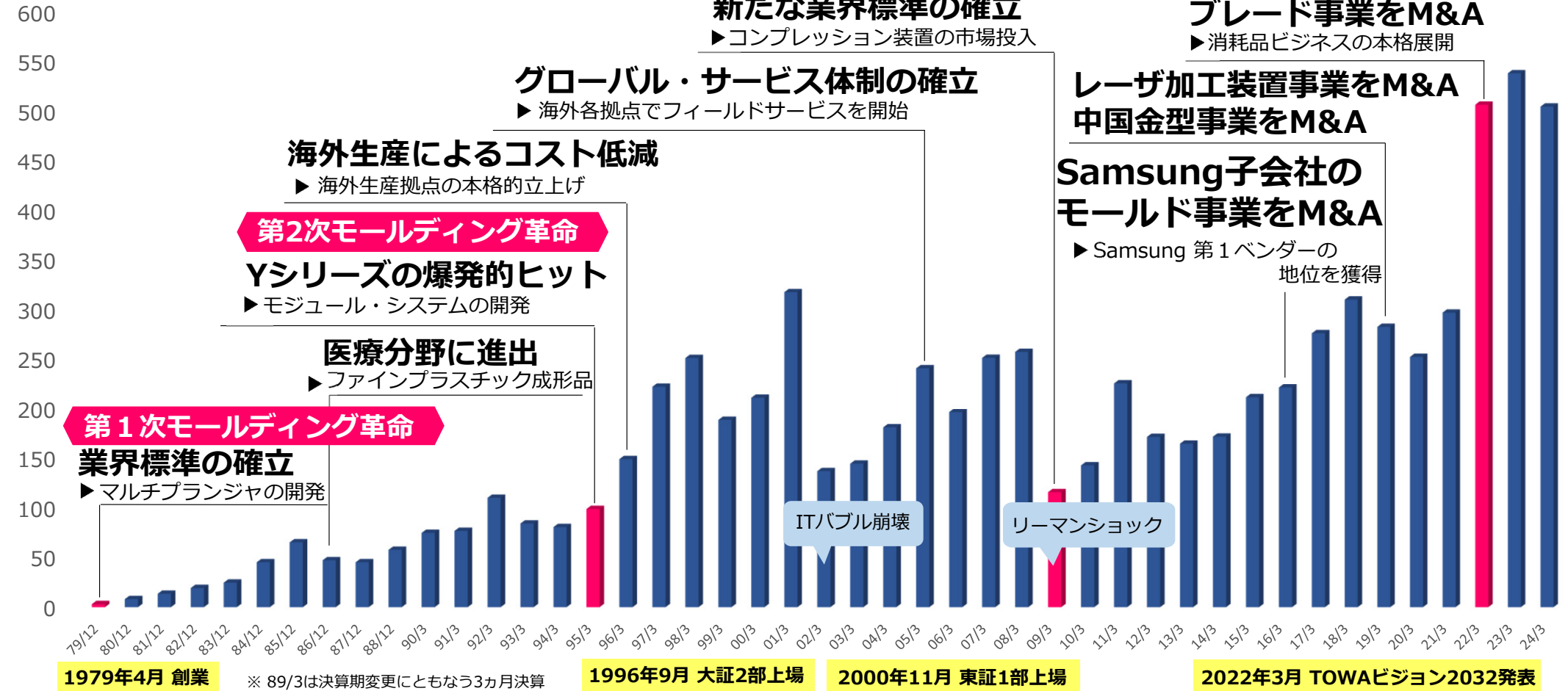
半導体樹脂封止（モールドディング）

半導体チップやワイヤーを樹脂で包み保護する



TOWAの歩み

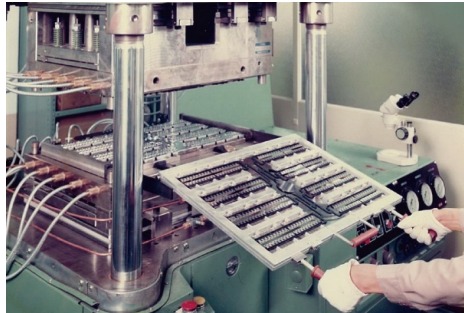
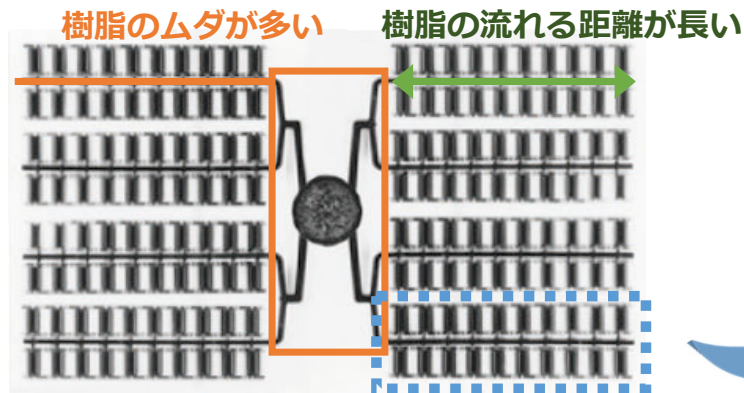
(億円)



第1次モールドディング革命(1979年)

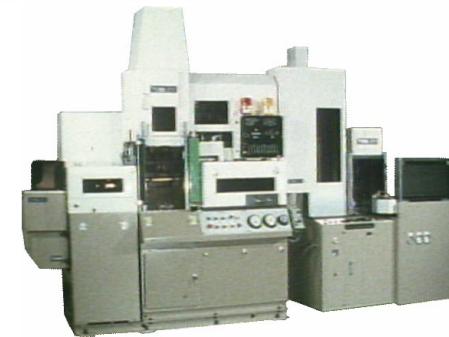
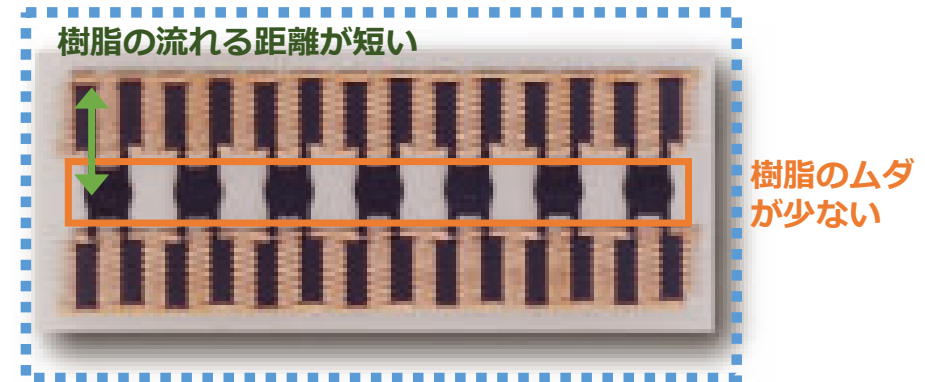
コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一カ所から注入し、**手動**で成形。樹脂の流れる**距離が長く**成形品質に**バラツキ**が出来、**樹脂のムダが多い**。



マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、**自動**で成形。樹脂の流れる**距離が短く**成形品質が**向上**し、**樹脂のムダが少ない**。



第2次モールドディング革命(1995年)

モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールドディング装置は・・・

- ・ 一品一様であり、生産する**製品毎に装置を買い替え**
- ・ 生産量に応じて**複数の装置を保有**する必要がある



モジュールシステムにより**プレス**の増減が可能に!!

- ・ Yシリーズだけで**様々な製品の生産が可能**
- ・ 生産量に応じて**追加で設備投資が可能**

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

世界に誇る半導体モールドディング装置のベストセラー



第3次モールドディング革命(2009年)

コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

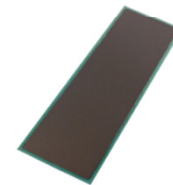
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、現在まで他社の追隨なし。

特 徴

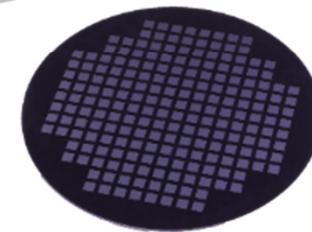
- ・樹脂使用効率**100%**（CO2排出量約**70%**削減）
- ・樹脂流動のない圧縮成形（不良品が**少ない**）
- ・メモリや5G向けなどの**最先端製品**に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



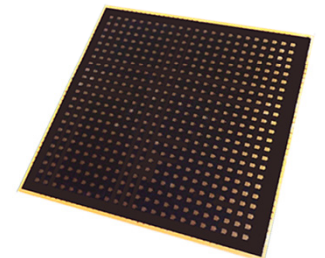
コンプレッション装置
Model PMC2030-D



基板サイズ
100×300mm



ウェハーサイズ
φ300mm



パネルサイズ
600mm×600mm

半導体パッケージへのソリューション

トランスファー成形

注入方式

樹脂流動
有

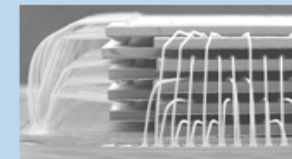
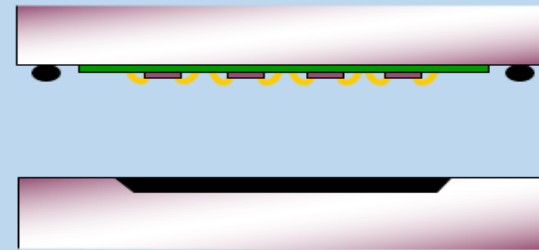


- ・未充填
- ・ワイヤダメージ発生

コンプレッション成形

圧縮方式

樹脂流動
無



- ・大判成形を実現
- ・製品へのダメージなし

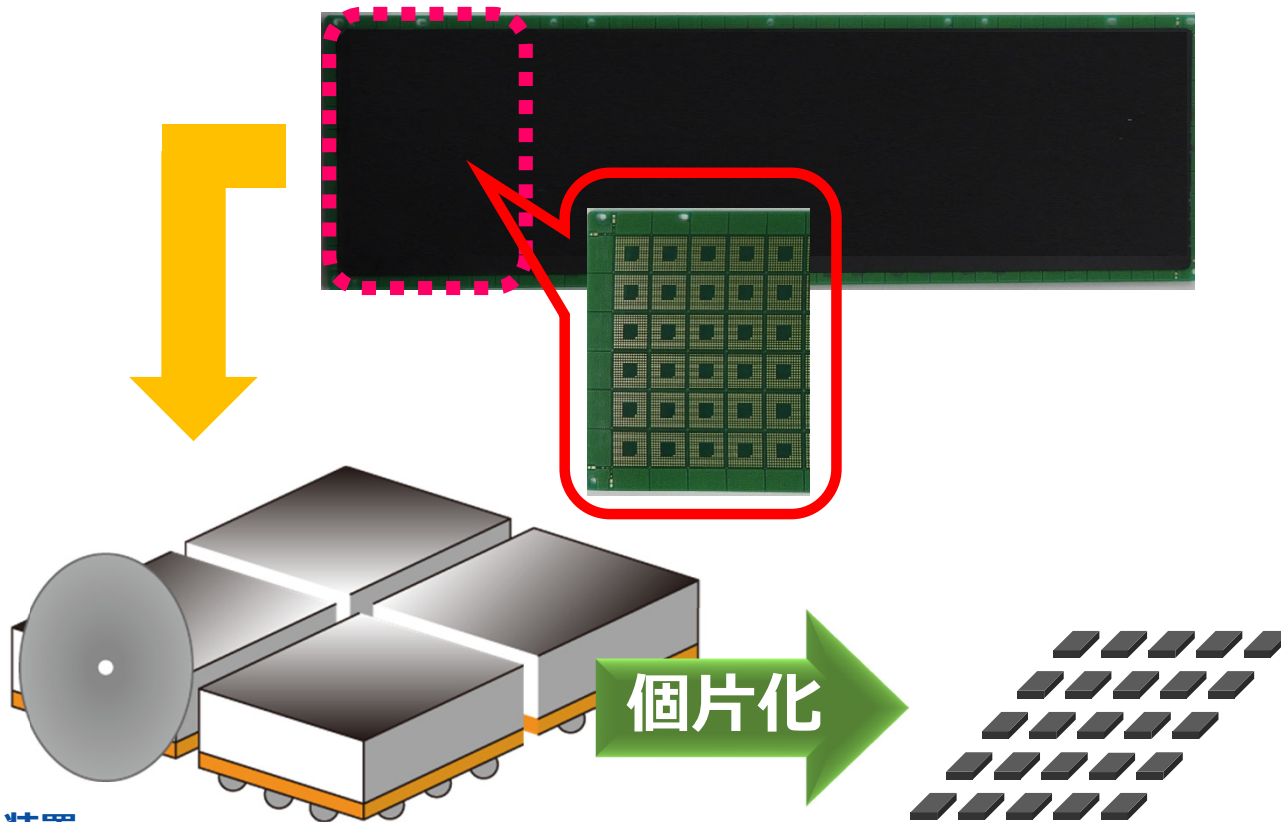
シンギュレーションプロセス

モールドディング後、1つ1つの半導体に個片化する

業界最小！
1.0×1.0mmの
個片化が可能



シンギュレーション装置
Model FMS 4040



半導体製造装置ラインナップ

～ Compression Mold ～

コンプレッション装置
Model CPM 1180



Work max size : 625x620mm

コンプレッション装置
Model CPM 1080



Work max size : φ300mm、320x320mm

コンプレッション装置
Model PMC 2030-D



Work max size : 100x300mm

～ Transfer Mold ～

トランスファ装置
Model YPM 1180



Work max size : 100x300mm

～ Singulation ～

シンギュレーション装置
Model FMS 4040



Work max size : 100x300mm